

湖南宇晶机器股份有限公司

关于 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、采取填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会〔2015〕31 号）等相关规范性文件的要求，为保障公司及中小投资者利益，结合公司具体情况，公司就本次发行对摊薄即期回报的影响进行了分析及风险提示，并修订了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、财务指标测算主要假设及说明

公司基于以下假设条件对本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析。以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本次以简易程序向特定对象发行股票发行方案和实际发行完成时间最终以中国证监会同意注册后的实际情况为准。具体假设如下：

- 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
- 2、假设公司于 2026 年 9 月末完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行并实际发行完成时间为准；
- 3、本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为 17,600.00 万元，不考虑发行费用的影响；假设以截至 2026 年 7 月 30 日，公司前 20 个交易日股票均价 80%测算，

本次发行股份数量为 5,858,854 股，不超过本次发行前上市公司总股本的 30%。上述募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股份价格、发行股份数量，本次发行采取询价发行方式，定价基准日为公司本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4、2026 年 4 月 29 日，公司披露《湖南宇晶机器股份有限公司 2025 年年度报告》，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,315.31 万元。为便于分析本次以简易程序向特定对象发行股票方案对公司主要财务指标的影响，假设 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与 2025 年度相比分别持平、增长 10%和下降 10%；

5、本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响；

6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等影响；

7、本次测算在预测公司总股本时，除本次以简易程序向特定对象发行股票的影响外，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

二、对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
期末股本总额（万股）	20,545.82	20,545.82	21,131.70
假设 1：2026 年扣非前后归母净利润较上年持平			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,315.31	1,315.31	1,315.31
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（万元）	-1,823.20	-1,823.20	-1,823.20
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06
扣除非经常性损益后基本每	-0.09	-0.09	-0.09

项目	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2026 年度/2026 年 12 月 31 日	
		发行前	发行后
股收益（元/股）			
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.09	-0.09
假设 2：2026 年扣非前后归母净利润均同比增长 10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,315.31	1,446.84	1,446.84
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（万元）	-1,823.20	-1,640.88	-1,640.88
基本每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.07	0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.08	-0.08
假设 3：2026 年扣非前后归母净利润均同比减少 10%			
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,315.31	1,183.78	1,183.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润（万元）	-1,823.20	-2,005.52	-2,005.52
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.06
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.10	-0.10

注：基本每股收益、稀释每股收益等指标系根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》规定的公式计算得出。

三、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模均相应增加，由于募投项目的建设和实施需要一定的时间周期，因此公司的净资产收益率和每股收益等财务指标在短期内可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本次发行完成后，公司原股东持股比例将会减少，亦将导致原股东的分红减少、表决权被摊薄的风险。前述测算财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。特此提醒投资者关注本次发行股票摊薄即期回报的风险。

四、董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次融资符合公司所处行业发展趋势和公司的未来发展规划，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析，详见同日披露的《湖南宇晶机器股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”的相关内容。

五、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司经过多年深耕发展，目前已形成“光伏+半导体+消费电子”三大业务矩阵，专注于高硬脆性材料切割、研磨抛光等设备和配套耗材的研发、生产与销售，构建了“设备+耗材+加工服务”一体化协同的产业布局，核心产品覆盖高精度数控多线切割机、研磨抛光机等，广泛应用于光伏、半导体、消费电子等高端制造领域，在行业内具有较高的品牌信誉度和良好的市场口碑。目前，公司切磨抛设备下游应用领域以光伏行业为主，占比约 90%；半导体和消费电子行业应用占比较低，报告期内半导体行业应用占比不超过 5%。

本次发行募投项目为 8-12 英寸大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备研发及产业化项目和海外营销服务中心建设项目，均与公司现有主营业务高度契合、紧密相关，是公司延伸业务链条、深化全球布局、实现战略目标的重要举措，具体关联如下：

8-12 英寸大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备研发及产业化项目，是在公司现有半导体设备业务基础上的延伸与升级。公司已成功研发 8 英寸碳化硅衬底切磨抛设备并实现小批量销售；已完成 12 英寸碳化硅切磨抛设备产品开发，目前正与下游多家厂商开展批量打样及测试验证工作，并已取得少量代加工及设备销售订单；12 英寸硅片切磨抛设备已完成产品开发，目前正与下游客户开展测试验证，尚未形成订单。本项目将聚焦 8-12 英寸大尺寸硅片及碳化硅高精密切磨抛设备核心零部件的产业化，拟购置一系列配套的机加工、恒温装配、生产检测、研发测试等软硬件设备，提升公司 8 英寸碳化硅设备的产能建设，逐步推进 12 英寸大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备的研发验证

与市场拓展工作。

海外营销服务中心建设项目，是公司现有营销业务的延伸与拓展，与公司全球化发展战略高度匹配。公司目前海外业务成效显著，已签订多笔海外光伏订单且正在陆续交付，海外市场已成为公司业绩增长的核心增量之一。本项目将通过在海外重点市场设立营销服务中心，完善海外营销网络布局，强化海外客户对接、产品推广、技术支持及售后服务能力，助力公司进一步拓展海外光伏、消费电子等设备市场，深化与海外客户的合作。

综上，本次两个募集资金投资项目均围绕公司现有核心业务展开，是公司巩固行业竞争力、拓展业务边界、实现高质量发展的重要布局，项目的顺利实施将进一步完善公司业务体系，强化核心竞争力，推动公司“光伏+半导体+消费电子”三大业务协同发展，助力公司实现长期战略目标。

2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（1）人才储备

公司高度重视人才培养、引进与赋能，经过多年发展，已逐步积累了一支资深、专业的研发、生产、营销及管理团队，为本次募投项目的顺利实施提供了坚实的人才保障。

研发及技术团队方面，公司核心成员深耕硬脆材料精密加工设备领域多年，具备丰富的行业经验和深厚的技术积累，能够精准把握半导体、光伏设备领域的前沿技术动态，推动技术创新与成果转化。公司持续加大人才投入，激发团队积极性，同时积极引进机械工程师、电气工程师、工艺工程师等研发技术类人才，不断扩充团队规模、优化人才结构，目前已形成一支覆盖设备研发、工艺优化、生产制造等全环节的专业团队，可直接支撑 8-12 英寸大尺寸硅片及碳化硅高精密磨抛设备的研发、生产等关键环节工作。

营销及管理团队方面，公司拥有一支经验丰富的营销队伍，熟悉国内外光伏、半导体设备市场的行业规则和客户需求，在海外市场已积累了一定的客户资源和营销经验，能够快速推进海外营销服务中心的建设与运营，高效开展海外市场拓展、客户维

护及售后服务工作。同时，公司建立了完善的人才培养体系，能够根据项目需求，持续提升团队的专业能力，为项目实施提供全方位的人才支撑。

（2）技术储备

公司始终坚持技术创新驱动发展，持续加大研发投入，聚焦硬脆材料高精密磨抛核心技术，经过多年积累，已形成了深厚的技术储备，完全具备支撑本次募投项目实施的技术能力，具体如下：

针对 8-12 英寸大尺寸硅片及碳化硅高精密磨抛设备研发及产业化项目，公司已具备扎实的技术基础。公司在半导体设备领域深耕多年，积累了丰富的设备研发、生产及工艺优化经验；同时，公司已完成 8-12 英寸大硅片及碳化硅切磨抛设备技术攻关，目前正处于测试验证阶段，且已在高精密磨抛精度控制、设备稳定性优化等核心技术方面形成了多项技术成果，为 8-12 英寸设备的批量生产提供了直接的技术支撑。

公司构建了“设备+耗材+加工服务”一体化协同的技术体系，在设备研发过程中可充分结合自身金刚石线等核心耗材的技术优势，优化设备与耗材的适配性，提升设备加工效率和产品良率，形成独特的技术协同优势，区别于单一设备厂商，为项目产品的市场竞争力提供了额外支撑。同时，公司持续加大研发投入，重点投入大尺寸切割、半导体研磨技术，不断推进技术升级迭代，能够及时响应 12 英寸大硅片加工设备的技术发展趋势和客户需求，为项目的长期推进提供持续的技术保障。

（3）市场储备

在市场布局方面，公司经过多年发展，成效显著且布局清晰，已积累了丰富的客户资源和市场经验，为本次募投项目的市场拓展奠定了坚实基础，具体如下：

国内市场方面，公司已进入光伏、半导体、消费电子领域下游多家企业供应链体系，具有一定的客户壁垒。海外市场方面，公司已开启全球化布局，近年来海外业务持续增长，境外销售收入实现增长，已累计签订多项海外光伏订单且正在陆续交付，积累了一定的海外客户资源和市场口碑。同时，全球光伏装机量持续高增，东南亚、欧美本土化产能建设带来大量设备采购需求，半导体设备国产替代浪潮向全球延伸，为公司海外营销服务中心的运营和项目产品的海外推广提供了良好的市场环境。

六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益，保证公司募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟采取如下具体措施：

1、加快推进募投项目实施进程，尽快实现预期效益

本次发行募投项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。为尽快实现募投项目效益，本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，提前完成募投项目的前期准备工作；本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行募投项目的实施工作，积极调配资源，积极推进募投项目的建设速度，争取早日实现预期效益。

2、加强募集资金管理，提高资金使用效益

本次募集资金到位后，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等内部制度的规定，加强募集资金存放和使用的管理，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，并将努力提高资金的使用效益。

3、提高经营管理和内部控制水平，提升经营效率，降低运营成本

公司将进一步加强经营管理，持续优化业务流程和内部控制制度，对各个业务环节进行标准化管理和控制。在日常经营管理中，加强对采购、生产、销售、研发等各个环节的管理，进一步推进成本控制工作，提升公司资产运营效率，降低公司营运成本，提升公司的经营业绩。

4、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

5、进一步完善利润分配制度，优化投资者回报机制

为了更好地保障股东回报，提高利润分配决策的透明性和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，制订了《关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》，对利润分配做出制度性安排，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

综上，为提高公司日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩，公司将持续开展精细化管理，不断优化业务流程，进一步优化管理组织架构，提高管理效率，减少管理费用，积极开拓市场，提高盈利水平；公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用；公司将持续优化投资者回报机制，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，降低公司即期回报被摊薄的风险。由于公司经营面临的内外部风险仍客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润作出保证。

七、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

1、控股股东、实际控制人出具的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“（一）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（二）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

（三）本人承诺，自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本人所做上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所规定的，本人将按照中国证监会或深圳证券交易所的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关措施。”

2、公司董事、高级管理人员出具的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“（一）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（二）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（三）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（四）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（五）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（六）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（七）自本承诺出具日至公司本次以简易程序向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会或深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会及深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日